

高屈曲でありながら高解像度 / 従来より簡便な工程でより薄いFPCを実現

High resolution with excellent flexibility /
Thinner FPC with simpler process



感光性カバーレイ FLEXFINER Series

Photo Imageable Coverlay FLEXFINER Series

特 長 Features

- **高解像性と高屈曲性の両立を実現した感光性ポリイミドフィルム**
Photo imageable polyimide film with high resolution and high bendability
- **現行のプリント配線板製造ラインへの適用を実現**
Applicable to current PWB photolithography process
- **優れた耐熱性と絶縁信頼性と難燃性 (VTM-0)**
Excellent heat resistance, insulation reliability and flame resistance (VTM-0)
- **各種電磁波シールドに対する優れた層間絶縁信頼性**
Excellent interlayer insulation with various type of EMI shield

特 性 Properties

はんだ耐熱性 Solderability

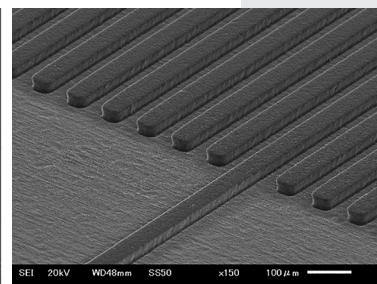
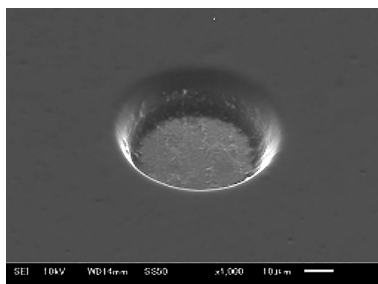
288°Cx10sx3times No delamination

屈曲性 Bendability

Folding: 20cycles (R=0mm)
MIT: 1000cycles (R=0.38mm)
IPC: 10,000,000cycles or more (R=5mm)

絶縁信頼性 Insulation Reliability

L/S=25/25 HHBT 100V/96Hrs+50V/404Hrs Pass



Item	Amber Type					Black Matte Type
	15SA	20SA	25SA	30SA	40SA	30EM-L
Film Thickness	15μm	20μm	25μm	30μm	40μm	30μm
Shelf life	24 Months at -15°C					

用 途 Application

- **モバイル・ウェアラブル** Mobile・Wearable
高密度FPC、FPCの薄膜化、
低スティフネスアプリケーション
High Density FPC, Thinner FPC, Applications requiring low stiffness

- **ロボティクス** Robotics
優れた摺動屈曲性を生かした
ダイナミックアプリケーション
Dynamic applications with excellent bending property